

2026年7月8日
富士ソフト株式会社

富士ソフト、SOM 販売事業を拡大し、AI・エッジ開発支援を強化 -台湾企業 2 社と販売店契約、半導体大手 MediaTek 製チップを搭載した SOM を国内展開



富士ソフト株式会社（代表取締役 社長執行役員 兼 CEO：室岡 光浩）は、このたび SOM（システム・オン・モジュール）※1 販売事業の拡大に向け、台湾の AMobile Solutions Corp.（以下、「AMobile」）および InnoComm Mobile Technology Corp.（以下、「InnoComm」）と販売店契約を締結しました。AMobile および InnoComm は、いずれも世界的な半導体大手企業である MediaTek の製品を手がけるテクノロジー企業です。本契約により富士ソフトは、MediaTek 製チップ搭載の SOM などを日本国内で販売開始します。

AI・エッジコンピューティング分野で採用が進む SOM

AI・エッジコンピューティングの活用が広がり、産業機器や情報端末そのものに高い処理性能が求められています。一方で、高性能な SoC（システム・オン・チップ）※2 を使った基板を自社で設計・検証するには、専門人材や開発期間、コスト面での負担が大きくなっています。こうした課題を解決する手段として、SOM の採用が進展、開発効率と柔軟性、リスク低減を同時に実現する中核ソリューションとして注目されています。

MediaTek の最新チップ搭載 SOM×富士ソフトのノウハウ

AMobile は MediaTek の最新のチップ情報を早期に入手し、製品へ迅速に展開できる強みを持ちます。InnoComm は、MediaTek 製 SoC の純正評価ボードを設計・製造しており、高い技術力と品質で知られています。富士ソフトは、2021 年から SOM 製品の販売を手がけており、導入に関する知識・経験を活かし、海外製品の導入に不安を持つ企業に対しても安心して利用できる環境を提供します。今回の販売店契約により富士ソフトは両社の SOM に加え、SBC（シングルボードコンピュータ）※3 や小型 BOX PC なども日本国内で販売します。

「売るだけではない」-システムインテグレーターとして製品化まで伴走

富士ソフトは両社の SOM 製品を中核に据え、SOM 販売事業を拡大します。両社の製品販売に加え、システムインテグレーターとして要件定義から SOM 選定、ソフト開発、量産・保守までを一貫して担い、お客様の AI・エッジ製品開発の効率化に貢献します。また、組込み・AI・クラウド連携の強みを活かし、高付加価値なソリューション提供を推進します。

AMobile Solutions Corp. 会長 Eric Lee 様からのコメント

「AMobile の MediaTek 搭載 SoM ソリューションを日本のお客様に提供するにあたり、富士ソフト株式会社と協業できることを大変光栄に思います。富士ソフトは、高い技術力、組込みシステム分野における豊富な実績、そしてお客様に寄り添ったサポート体制を備えており、日本市場における理想的なパートナーです。本協業を通じて、AI およびエッジコンピューティングソリューションの開発と事業化が、より円滑に進むことを期待しています。

AMobile は今後も、産業機器、小売、医療、物流をはじめとするさまざまな分野において、富士ソフトとともに新たな価値創出を支える信頼性の高い技術と製品を提供してまいります。」

InnoComm Mobile Technology Corp. CFO CH Liu 様からのコメント

「このたび富士ソフト様とパートナーシップを締結できたことを大変嬉しく思います。本協業は、InnoComm のエッジ AI コンピューティングおよび組込みプラットフォーム事業を日本市場で拡大するうえで、重要なマイルストーンになると確信しております。市場調査によると、日本のエッジコンピューティング市場は、2025 年の約 10.2 億米ドルから 2034 年には 63.3 億米ドルへと成長すると予測されており、AI、IoT、そして Industry 4.0 技術の導入が加速していることを示しています。※4

InnoComm は、エッジ AI コンピューティングプラットフォーム、組込み AI ソリューション、ならびにインテリジェントコネクテッドデバイス技術を提供する企業として、お客様の製品開発および AI イノベーションの加速を支援する、拡張性が高く市場投入が容易なプラットフォームの提供に取り組んでいます。また、ソフトウェア開発、システムインテグレーション、そして国内のお客様へのサポート体制において豊富な実績を持つ富士ソフト様との連携により、日本市場の進化するニーズに対応できる体制が整うと考えております。

今後は富士ソフト様とともに革新的なエッジ AI プラットフォームを提供し、日本国内における AI 搭載組込みソリューションの普及拡大を推進するとともに、お客様のさらなる価値創出に貢献してまいります。」

※1 SOM : CPU、メモリ、電源など、機器を動かすための主要機能を 1 枚の基板にまとめた組込みシステム

※2 SoC : 半導体チップ上にプロセッサ、メモリ、I/O ポートなどの主要なコンポーネントを統合した集積回路

※3 SBC : SoC などを搭載し、単体で動作するコンピュータ機能を持つ基板

※4 Japan Edge Computing Market Size, Share, Trends and Forecast by Component, Organization Size, Vertical, and Region, 2026-2034

<https://www.imarcgroup.com/japan-edge-computing-market>

AMobile 製品ラインナップ

<https://www.fsi-embedded.jp/product/amobile/>

SOM

・SoM-SD510

- ・SoM-SD521
- ・SoM-SD721
- ・SoM-SD700
- ・SoM SM1200
- ・SoM-OSM360
- ・SoM-OSM350

SBC

- ・SBC-MB510
- ・SBC-MB521
- ・SBC-MB710
- ・SBC-MB721

BOX PC

- ・MX-110

InnoComm 製品ラインナップ

<https://www.fsi-embedded.jp/product/innocomm/>

SOM

- ・SoM G700
- ・SoM G510
- ・SoM G350
- ・SOG36 & SOG36P
- ・SOG52 & SOG72
- ・SOG52 & SOG72 (STARTER KIT)

AMobile Solutions Corp. について

<https://www.amobile-solutions.com/>



AMobile Solutions Corp.は、半導体大手のMediaTekと産業用コンピュータ大手のARBOR Technologyの共同出資によって設立された、台湾のテクノロジー企業です。高耐久なハンドヘルド通信機器や堅牢型タブレット、マシンビジョン処理技術などを提供しています。「オールインワン」の生産モデルに加え、MediaTek との合併企業である強みを活

かして最新のチップ技術へのアクセスを可能にしています。これにより、倉庫管理、車載システム、小売、公共安全、医療、軍事・防衛など、様々な産業に向けた多機能ハンドヘルド製品の開発・製造を実現しています。

InnoComm Mobile Technology Corp. について

<https://www.innocomm.com/ja-jp>



InnoComm Mobile Technology Corp. は、ワイヤレス、AI、IoT 分野における革新を牽引する台湾のテクノロジー企業です。MediaTek 製 SoC の純正評価ボードを設計・製造するパートナーとして、MediaTek 製品に関する高度な技術力と品質の信頼性を強みとしています。コンセプト設計からハードウェア・ソフトウェアの製品開発、高品質な台湾製造での量産まで、バリューチェーン全体をカバーする一貫体制のもと、スマートヘルスケア、スマートリテール、スマート物流など多様な業界ニーズに対応するワンストップの ODM パートナーとして、アイデア実現へと導きます。

関連情報

富士ソフト組み込み開発サイト

<https://www.fsi-embedded.jp/>

『MediaTek Genio』搭載 SoM/SBC 特集

https://www.fsi-embedded.jp/mediatek_genioseries/

富士ソフト株式会社について

事業内容：コンサルティング、開発、システム構築、サポートまでのトータルソリューション

URL：<https://www.fsi.co.jp/>

富士ソフトは、個のエンジニアリング力と高度な組織力を結集し、AI・IT・OT の融合によりお客様の未来を創造するデジタルイノベーションカンパニーです。1970 年の創業以来、組込・制御技術と各産業に最適化されたソリューションで実績を築き、組込／制御分野では自動車やロボットなどの先端領域、ソリューション分野では業務系開発や官公庁・電力など社会インフラを支えてきました。2026 年より新理念「社会の発展とおお客様の価値創出に寄り添う、かけがえのない存在であり続ける」を掲げ、「組込／制御」「社会インフラ」「ソリューション」事業における先進技術と組織力を強みに、多様なオファリングを展開。経営変革の伴走パートナーとして、常にイノベーションに挑戦しながら、お客様と共に未来を創造し続けます。

お問い合わせ先

ニュースリリースについて

コーポレートコミュニケーション部 広報窓口

TEL : 050-3000-2735

E-MAIL : mkoho@fsi.co.jp

製品・サービスについて

組込／制御ビジネスユニット インダストリー事業本部 エンベデッドソリューション推進部

TEL : 050-3000-2102

E-MAIL : ep_distribution@fsi.co.jp

※ 記載されている会社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。